



第25届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国-天津

ICEPT 2024 主要嘉宾

(排名不分先后)

毕克允 电子部第13研究所前所长

叶甜春 国家科技重大专项02专项专家组组长

姜勇 天津工业大学校长

汪正平 中国工程院外籍院士、美国国家工程院院士、香港科学院院士、IEEE Fellow

过增元 中国科学院院士

刘胜 中国科学院院士、IEEE Fellow

马莒生 IEEE Fellow、清华大学教授、东京大学 Fellow

刘建影 瑞典查尔姆斯理工大学教授、瑞典皇家工程科学院院士、IEEE Fellow

张国旗 荷兰工程院院士，IEEE Fellow、IEEE 国际宽禁带电力电子技术路线图委员会秘书长；荷兰 Delft 大学微纳电子系统集成与可靠性主任教授

John H LAU IEEE Fellow、台湾 Unimicron 公司技术专家

Tadatomo SUGA 东京大学名誉教授、明星大学教授

Kitty PEARSALL 博士，IEEE EPS

郭一凡 易卜半导体联合创始人、IEEE Fellow

李世玮 IEEE Fellow、香港科技大学

李宁成 IEEE Fellow、中国炫纯材料公司创始人

樊学军 IEEE Fellow、美国拉马尔大学教授

Weikoh IEEE Fellow 美国 Pacrim 创始人

Andrew Tay IEEE Fellow、ASME Fellow

刘勇 IEEE Fellow、美国安森美公司技术专家

罗小兵 IEEE Fellow、华中科技大学能源学院院长

曹立强 中国科学院微电子研究所副所长

王启东 中国科学院微电子研究所系统封装与集成研发中心主任

梅云辉 天津工业大学科学技术研究院院长兼电气工程学院常务副院长

张建华 上海大学副校长

孙蓉 深圳先进电子材料国际创新研究院创研院长，中科院深圳先进院材料所所长

崔成强 广东工业大学教授、佛智芯创始人

Scott CHEN 日月光工程中心资深副总

- YP WANG** SPIL 研发中心副总裁
- 侯召政** 华为数字能源技术与平台规划部部长
- Viorel Dragoi** EV Goup 首席科学家
- Gu-Sung Kim** 韩国江南大学教授，电子封装研究中心创始人
- Suganuma Katsuaki** 日本大阪大学 F3D 实验室教授
- Farhang Yazdani** BroadPak Corporation CEO
- 沙超群** 海光信息董事长
- 小林大士** 爱发科集团先进技术研究所 所长
- 王 玮** 北京大学集成电路学院副院长、微米纳米加工技术全国重点实验室主任
- 刘志权** 中国科学院深圳先进技术研究院研究员、中国科学院百人计划海外引进学者
- 杭 弢** 上海交通大学教授，材料学院副院长，电子材料与技术研究室所长
- 刘丰满** 中国科学院微电子研究所教授
- 杨道国** 桂林电子科技大学“电子信息材料与器件教育部工程研究中心”副主任、广西电子封装与组装技术工程研究中心主任
- 蔡 坚** 清华大学教授、集成电路学院党委书记
- 黄明亮** 大连理工大学材料科学与工程学院 院长、大连理工大学电子封装材料研究所所长
- 陈志文** 武汉大学教授、湖北省杰青、电子制造与封装集成湖北省重点实验室副主任
- 张 昱** 广东工业大学教授、校“青年百人计划”A类引进人才
- 秦 飞** 第十三届全国人民代表大会代表、北京工业大学电子封装技术与可靠性研究所所长
- 杨晓锋** 工业和信息化部电子第五研究所可靠性实验室技术总师
- 叶怀宇** 南方科技大学教授、深圳第三代半导体研究院封装项目负责人
- 牛萍娟** 天津工业大学电子与信息工程学院常务副院长兼党委副书记
- 尚金堂** 东南大学教授、卓越青年科学基金获得者
- 肖 克** 中科院上海微系统所教授
- 于大全** 厦门大学特聘教授、厦门云天半导体董事长
- 田艳红** 哈尔滨工业大学先进焊接与连接国家重点实验室副主任、国家优秀青年基金获得者
- 郑雪峰** 西安电子科技大学微电子学院院长兼集成电路学部副主任
- 郭宇铮** 武汉大学动力与机械学院副院长
- 张童龙** 海思半导体有限公司高级技术专家
- 陈维恕** 夸泰克（广州）新材料公司副总经理
- 张国平** 中科院深圳先进技术研究院材料所副所长、集成电路材料国家重点实验室副主任
- 陈传彤** 日本大阪大学 3D 电子封装集成研究所副教授
- Karsten Meier** 德国德累斯顿工业大学电子封装技术研究所助理主任
- 王 新** 杭州晶通科技有限公司首席技术官、研发副总
- 张 源** 半导体专家级讲师
- 车法星** 美光半导体新加坡高级技术工程师
- 徐思行** 湖南大学副教授
- 张 靖** 贺利氏电子中国研发总监
- 樊海波** 安世半导体香港高级首席工程师
- 宁 达** 肖特玻璃中国区半导体业务负责人
- 杨荣贵** 北京大学教授
- 孙 鹏** 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司总经理
- 杨秉君** 爱发科集团执行役員、中国区总裁
- 周雅萍** 迪思科科技（中国）有限公司副总经理
- 朱永兵** 天津海瑞电子科技有限公司总经理

范正强 天津海瑞电子科技有限公司副总经理

韩佐晏 广东天承科技股份有限公司 CTO

贺育方 广东伊帕思新材料科技有限公司总经理

黄晓娴 夸泰克(广州)新材料有限责任公司总经理

苏德志 山东华宇航天空间技术有限公司副总经理

宁效庆 浙江伟思试验设备有限公司总经理

李元雄 芜湖立德智兴半导体有限公司 CTO

张洪泽 中国电子科技集团有限公司第五十五研究所副主任

Hua Younan Wintech-Nano, VP

周 凯 上海道宜半导体 COO

Li Ma Indium corporation, Senior Research Chemis, Specialist

JayZhang Corning Incorporated, Business Development Director

赵 波 湖北九峰山实验室 TD 负责人/主任工程师

Yang ZHOU Archimedes Semiconductor CTO
广东天承科技股份有限公司技术总监

周国富 英国工业显微镜有限公司销售总监

张 伍 深圳市山木电子设备有限公司运营总监

刘云兵 芬泰电子（上海）有限公司中国区总监

谭 平 中科化新材料技术（东莞）有限公司总经理

任海忠 北京华微世纪科技有限公司副总

李金平 中国电子系统工程第二建设有限公司有限公司

任开阔 天津凯华绝缘材料股份有限公司总经理

谢贵久 北京中电科电子装备有限公司总经理